

嘉兴斯达半导体股份有限公司 截至2020年9月30日为止的 前次募集资金使用情况报告

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，将截至2020年09月30日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金的募集及存放情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]2922号）核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,000.00万股，发行价格为每股12.74元。

公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.00万股，募集资金总额人民币50,960.00万元，扣除承销费和保荐费人民币3,500.00万元（含税价）后的募集资金为人民币47,460.00万元，已于2020年1月21日全部到账。本次募集资金总额人民币50,960.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,010.67万元后，实际募集资金净额人民币45,949.33万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第ZA10026号验资报告。

（二） 募集资金使用情况及结余情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》（上证公字[2013]13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉兴斯达半导体股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。

2020年1月23日，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司嘉兴分行营业部、杭州银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年6月29日，子公司上海道之科技有限公司（以下简称上海道之）与公司作为募投项目新能源汽车用IGBT模块扩产项目实施主体，会同保荐机构中信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按监管协议的规定履行，不存在重大问题。

截至2020年9月30日止，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行名称	银行账号	存储方式	初始存放金额	截止日余额
嘉兴斯达半导体股份有限公司	交通银行股份有限公司嘉兴分行营业部	334899991013000045994	活期	117,991,300.00	9,830,477.22
嘉兴斯达半导体股份有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	19310101040021256	活期	200,000,000.00	454,117.32
嘉兴斯达半导体股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000575875	活期	156,608,700.00	2,223,268.41
上海道之科技有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000630548	活期		14,046,231.95
合计				474,600,000.00	26,554,094.90

二、前次募集资金使用情况

截至2020年9月30日止，公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

三、前次募集资金变更情况

截至2020年9月30日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司于2020年6月23日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,148.06万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15013号）。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

截至2020年9月30日止，公司前次募集资金投资项目尚未完成，仍在持续投入中。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年6月23日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过10,000.00万元暂时闲置募集资金用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见。截止2020年9月30日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为8,000.00万元，上海道之实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为2,000.00万元。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年2月14日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，使用不超过人民币2.4亿元（含2.4亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。

公司于2020年4月28日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不超过人民币50,000.00万元暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。期限为股东大会审议批准之日起至下次有权授权机构批准作出新的决议前有效。在上述额度在决议有效期内，可以滚动使用。

截至2020年9月30日止，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况如下：

单位：人民币万元

签约方	签约银行	产品名称	实际使用金额	起始日期	终止日期	收益金额	期末投资份额	是否如期归还
嘉兴斯达半导体股份有限公司	交通银行股份有限公司 嘉兴分行营业部	蕴通财富定期结构性存款 (汇率挂钩) 2699200991	8,400.00	2020年2月24日	2020年4月27日	56.54		是
嘉兴斯达半导体股份有限公司	交通银行股份有限公司 嘉兴分行营业部	蕴通财富定期结构性存款 (黄金挂钩) 2699202111	9,000.00	2020年5月6日	2020年8月12日	3.26		是
嘉兴斯达半导体股份有限公司	交通银行股份有限公司 嘉兴分行营业部	蕴通财富定期结构性存款 (黄金挂钩) 2699202112	1,000.00	2020年5月6日	2020年6月10日	86.99		是
嘉兴斯达半导体股份有限公司	杭州银行股份有限公司 嘉兴分行	“添利宝”结构性存款 TLB20200756	15,600.00	2020年2月21日	2020年5月21日	151.94		是
嘉兴斯达半导体股份有限公司	杭州银行股份有限公司 嘉兴分行	“添利宝”结构性存款 TLB20202698	15,830.00	2020年5月25日	2020年6月28日	47.19		是
上海道之科技有限公司	杭州银行股份有限公司 嘉兴分行	“添利宝”结构性存款 TLB20203569	4,900.00	2020年8月21日	2020年9月21日	12.90		是
上海道之科技有限公司	杭州银行股份有限公司 嘉兴分行	“添利宝”结构性存款 TLB20203817	4,900.00	2020年9月23日	2020年12月23日		4,900.00	

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日止，公司未使用的募集资金余额为 174,991,518.98 元（含累计募集资金理财收益利息收入减手续费支出净额），占前次募集资金净额的比例为 38.08%。前次募集资金投资项目尚未完成，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

九、前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司已公开披露的有关内容不存在差异。

嘉兴斯达半导体股份有限公司

2021 年 3 月 2 日



附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至2020年9月30日止

编制单位: 嘉兴斯达半导体股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金总额:		459,493,305.50		已累计使用募集资金总额:		289,200,827.07	
变更用途的募集资金总额:		不适用		各年度使用募集资金总额:		289,200,827.07	
变更用途的募集资金总额比例:		不适用		2020年1-9月:		289,200,827.07	
序号	投资项目名称	募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额		
1	新能源汽车用IGBT模块扩产项目	159,493,305.50	159,493,305.50	159,493,305.50	159,493,305.50	-82,825,910.05	-
2	技术研发中心扩建项目	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-87,465,367.76	-
3	补充流动资金	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-1,200.62	-
合计		459,493,305.50	459,493,305.50	459,493,305.50	459,493,305.50	-170,292,478.43	-